股票代码：688347　　股票简称：华虹公司　　上市地点：上海证券交易所

华虹宏力 HHGRACE

华虹半导体有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要（修订稿）

交易类型	交易对方名称
发行股份购买资产	上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
募集配套资金	不超过35名符合条件的特定对象

独立财务顾问

国泰海通证券股份有限公司 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年三月

上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在华虹半导体届时拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交华虹半导体董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除重组报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询其股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次交易的交易对方承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺：本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如其为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。

释 义

本报告书摘要中，除非文义载明，下列词语具有如下含义：

一、一般名词释义		
预案、重组预案	指	《华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书	指	《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
本报告书摘要	指	芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》
华虹半导体、华虹公司、本公司、公司、上市公司	指	华虹半导体有限公司
本次交易、本次重组、本次收购、本次发行	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司等4名交易对方持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
本次发行股份购买资产	指	上市公司拟通过发行股份的方式购买上海华虹（集团）有限公司等4名交易对方持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权
标的公司、华力微	指	上海华力微电子有限公司
标的资产、交易标的	指	上海华力微电子有限公司97.4988%股权
发行股份购买资产协议	指	公司与交易对方就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
发行股份购买资产协议之补充协议	指	公司与交易对方就本次交易签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
减值补偿协议	指	华虹半导体有限公司与上海华虹（集团）有限公司之减值补偿协议
资产评估报告	指	华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告
华虹集团	指	上海华虹（集团）有限公司
华虹国际	指	Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司）
大基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
上海集成电路基金	指	上海集成电路产业投资基金股份有限公司
国投先导基金	指	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）
交易对方	指	华虹集团、大基金二期、上海集成电路基金、国投先导基金
华虹宏力	指	上海华虹宏力半导体制造有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
华虹NEC	指	上海华虹NEC电子有限公司
中国日电	指	日电（中国）有限公司
张江集团	指	上海张江（集团）有限公司
上海贝岭	指	上海贝岭股份有限公司
NEC	指	NEC Corporation（日本电气株式会社）
Newport	指	Newport Fab LLC
张江国际	指	Shanghai Zhangjiang International Corporation（上海张江国际有限公司）
鑫芯香港	指	Xinxin（Hongkong）Capital Co., Limited（鑫芯（香港）投资有限公司）
华力集	指	上海华力集成电路制造有限公司
独立财务顾问/国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司
法律顾问/律师/通力律师	指	上海通力律师事务所
审计机构/大华会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
备考审阅机构/安永会计师	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/东洲评估	指	上海东洲资产评估有限公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
中芯国际	指	中芯国际集成电路制造有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司
芯联集成	指	芯联集成电路制造股份有限公司
台积电	指	台湾积体电路制造股份有限公司
联华电子	指	联华电子股份有限公司
格芯	指	格芯股份有限公司（原：Global Foundries Inc.）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港证监会	指	香港证券及期货事务监察委员会
定价基准日	指	上市公司2025年第六次董事会决议公告日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司条例》	指	中国香港《公司条例》（香港法例第622章）（自2014年3月3日起）及其不时修订
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《华虹半导体有限公司之组织章程细则》
股东大会	指	华虹半导体有限公司股东大会
董事会	指	华虹半导体有限公司董事会
科创板	指	上海证券交易所科创板
A股	指	在中国境内证券交易所上市的以人民币认购和进行交易的普通股股票
交割日	指	交易对方向上市公司转让标的资产的工商变更登记手续完成，标的资产登记至上市公司名下之日；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移至上市公司
发行日	指	上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之日
过渡期	指	自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）止的期间
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业名词释义		
晶圆	指	晶圆指制造半导体芯片的衬底（也叫基片）。由于是圆形晶体材料，所以称为晶圆。按照直径进行分类，主要包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等规格
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等组件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽，用来衡量半导体芯片制造的工艺水准，线宽越低，则制程水平越高
嵌入式	指	将IP模块或工艺模块集成至芯片或基础工艺的简称
嵌入式非易失性存储器	指	Embedded Non-Volatile Memory，缩写为eNVM，用于满足各种嵌入式系统应用程序的小型芯片，eNVM被广泛应用于需要存储代码程序、客户数据或其他重要信息的芯片，如智能卡芯片、MCU等
独立式非易失性存储器	指	Standalone Non-Volatile Memory，缩写为sNVM，是一种独立于数据处理芯片单独封装的存储器件，其核心特征是断电后数据不丢失，并通过标准化接口（如USB、PCIe、NVMe）与主机系统通信
高压	指	高压显示驱动
功率器件	指	分立器件板块的一个分支，主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件，如MOSFET、SJ和IGBT
电源管理芯片	指	电源管理芯片（Power Management Integrated Circuits，PMIC），是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片
SONOS	指	硅基-二氧化硅-氮化硅-二氧化硅-多晶硅，一种存储结构
Flash/闪存	指	是一种非易失性存储器的形式，允许在操作中被多次擦或写的存储器
ISP	指	Image Signal Processor，图像信号处理器，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元
MCU	指	Micro controller Unit，微控制单元，又称单片微型计算机或者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制
AIoT	指	AI+IoT，即人工智能+物联网
SRAM	指	Static Random Access Memory，静态随机存取存储器，是一种半导体存储器，主要用于芯片内的缓存
IP	指	半导体IP（Intellectual Property），一般指在集成电路设计中，经过验证的、可重复使用且具备特定功能的集成电路模块
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造工厂，是集芯片设计、芯片制造、封装测试及产品销售于一体的整合元件制造商，属于半导体行业的一种业务模式
Foundry	指	泛指晶圆代工模式，专门负责芯片制造，不负责芯片设计，可同时为多家芯片设计公司或IDM公司提供代工服务
逻辑电路	指	传递和处理离散信号，以二进制为原理，实现数字信号逻辑运算和操作的电路
射频	指	高频交流变化电磁波的信号处理电路
CIS	指	CMOS Image Sensor，CMOS图像传感器
PDK	指	Process Design Kit，工艺设计套件，是集成电路设计流程中的重要工具包
NB-IOT	指	Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，是一种由3GPP标准化的低功耗广域网（LPWAN）技术，基于蜂窝网络，专为物联网应用设计
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，现场可编程逻辑门阵列，是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进一步发展的产物，在硬件层面可重复进行编程，以满足多种应用需要
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管显示器
CMOS	指	CMOS（Complementary Metal-Oxide-Semiconductor），互补金属氧化物半导体。CMOS的制造技术原理主要是利用共存着带N（带-电）和P（带+电）极的半导体
nm	指	纳米，10⁻⁹米

正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。

重大事项提示

本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上交所官方网站。

特别提醒投资者认真阅读重组报告书全文，并特别注意下列事项（本部分引用的简称见本报告书摘要“释义”）：

一、本次交易方案概况

（一）本次交易方案

交易形式		发行股份购买资产并募集配套资金	
交易方案简介		上市公司拟通过发行股份方式向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。	
交易价格（不含募集配套资金金额）		826,790.22万元	
交易标的	名称	上海华力微电子有限公司	
	主营业务	主要从事12英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。	
	所属行业	C39计算机、通信和其他电子设备制造业	
	其他	符合板块定位	√是 否 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	√是 否
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 否
交易性质		构成关联交易	√是 否
		构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	是 √否
		构成重组上市	是 √否
本次交易有无业绩补偿承诺			是 √否
本次交易有无减值补偿承诺			√是 否
其他需特别说明的事项			无

（二）标的资产评估作价情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第2446号），本次交易对华力微采用了资产基础法、市场法进行评估，最终选用市场法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2025年8月31日，华力微报表归属于母公司所有者权益账面价值为200,191.38万元，评估值为848,000.00万元，评估增值647,808.62万元，增值率323.59%。

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果（万元）	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格（万元）	其他说明
华力微	2025年8月31日	市场法	848,000.00	323.59%	97.4988%	826,790.22	-

（三）本次交易支付方式

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易股权比例	支付方式				向该交易对方支付总对价
			现金对价	股份对价	可转债	其他	
1	华虹集团	63.5443%	0.00	538,855.12	无	无	538,855.12
2	上海集成电路基金	15.7215%	0.00	133,318.65	无	无	133,318.65
3	大基金二期	10.2503%	0.00	86,922.77	无	无	86,922.77
4	国投先导基金	7.9827%	0.00	67,693.68	无	无	67,693.68
合计		97.4988%	0.00	826,790.22		-	826,790.22

（四）发行股份购买资产的具体情况

股票种类	境内人民币普通股（A股）	每股面值	根据《公司条例》第135条，公司本次发行的人民币普通股（A股）股票无面值
定价基准日	上市公司2025年第六次董事会决议公告日	发行价格	43.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的80%
发行数量	190,768,392股，占发行后上市公司总股本的比例为9.89%（不考虑募集配套资金）		
是否设置发行价格调整方案	是√否（在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整）		
锁定期安排	1、华虹集团本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得进行转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，则华虹集团通过本次交易取得的前述上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月； 2、上海集成电路基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得进行转让。如果上海集成电路基金符合《重组管理办法》第四十一条第三款第（一）项规定，则其本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起6个月内不得进行转让； 3、大基金二期、国投先导基金本次交易中以华力微股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得进行转让；如其取得前述上市公司股份时，对于用于认购上市公司股份的华力微股权权益持续拥有权益的时间不足12个月，则该等华力微股权对应的在本次交易中相应取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不得进行转让。 股份锁定期内，交易对方通过本次交易所取得的新增股份因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，亦应遵守上述股份限售安排。若上述限售期安排与届时有效的法律、法规、部门规章及规范性文件的规定不相符或与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关规定或监管意见相应调整。		

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金概况

募集配套资金金额	755,628.60万元		
发行对象	不超过35名特定对象		
募集配套资金用途	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
	华力微技术升级改造项目	329,476.00	43.60%
	华力微特色工艺研发及产业化项目	56,152.60	7.43%
	补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用	370,000.00	48.97%
	合计	755,628.60	100.00%

（二）募集配套资金的具体情况

股票种类	A股（人民币普通股）	每股面值	根据《公司条例》第135条，公司本次发行的人民币普通股（A股）股票无面值
定价基准日	本次募集配套资金的发行期首日	发行价格	价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行价格将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。
发行数量	上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套募集资金发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。本次募集配套资金发行股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股份发行价格。若发行数量计算结果不是一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如出现派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，上述发行股份数量将根据中国证监会及上交所颁布的规则作相应调整。		
锁定期安排	本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项增加的，亦应遵守上述约定。前述锁定期与适用法律或证券监管机构（包括但不限于中国证监会和上交所）的最新监管意见不相符，将根据适用法律或相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。		

三、本次交易的性质

（一）本次交易不构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买华力微97.4988%股权。本次交易拟购买资产最近一期末经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表相关指标的比例如下：

单位：万元

项目	资产总额与交易金额孰高	资产净额与交易金额孰高	营业收入
华力微97.4988%股权	826,790.22	826,790.22	510,114.63
上市公司	10,012,329.13	4,516,029.04	1,729,145.07
指标占比	8.26%	18.31%	29.50%

注1：上表华力微97.4988%股权的“资产总额与交易金额孰高”、“资产净额与交易金额孰高”均取相应交易金额，“营业收入”取华力微2025年度营业收入；

注2：上市公司、华力微的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2025年度财务报表。

如上，本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例均未超过50%，因此本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易构成关联交易

本次发行股份购买资产的交易对方中，华虹集团系上市公司的间接控股股东，上海集成电路基金系上市公司董事曾担任董事的企业，根据《科创板上市规则》，本次交易构成关联交易。

上市公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事、关联股东均已回避表决。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，公司直接控股股东均为华虹国际，间接控股股东均为华虹集团，实际控制人均为上海市国资委，预计不会导致公司实际控制权变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市。

四、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

本次交易前，上市公司作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业及行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司以拓展特色工艺技术为基础，主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

标的公司主要为客户提供12英寸集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

标的公司与上市公司均拥有65/55nm、40nm制程代工工艺，通过本次交易，上市公司将进一步提升公司12英寸晶圆代工产能，双方的优势工艺平台可实现深度互补，共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务，能够为客户提供更多样的技术解决方案，丰富产品体系。同时，通过研发资源整合与核心技术共享，双方有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应，加速技术创新迭代，共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力。另外，上市公司将通过整合管控实现一体化管理，在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次的整合，通过降本增效实现规模效应，提升公司的市场占有率与盈利能力。

（二）本次交易对上市公司规模结构的影响

截至2025年12月31日，上市公司总股本为1,737,614,193股，公司直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次交易拟向交易对方发行190,768,392股。本次交易前后（不考虑募集配套资金）上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	820,333,688	47.21%	820,333,688	42.54%
华虹国际	347,605,650	20.00%	347,605,650	18.03%
联和国际有限公司（Sino-Alliance International, Ltd.）	160,545,541	9.24%	160,545,541	8.33%
华虹集团	1,198,517	0.07%	125,530,570	6.51%
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	48,334,249	2.78%	68,390,263	3.55%
上海集成电路基金	-	-	30,761,109	1.60%
国投先导基金	-	-	15,619,216	0.81%
招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金	11,020,000	0.63%	11,020,000	0.57%
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	10,697,339	0.62%	10,697,339	0.55%
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	9,267,853	0.53%	9,267,853	0.48%
海通创新证券投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
国泰君安证裕投资有限公司	8,155,000	0.47%	8,155,000	0.42%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,077,517	0.35%	6,077,517	0.32%
其他股东	306,223,839	17.62%	306,223,839	15.88%
合计	1,737,614,193	100.00%	1,928,382,585	100.00%

注：重组前股份数量、持股比例为截至2025年12月31日数据。

本次交易完成后，公司直接控股股东仍为华虹国际，间接控股股东仍为华虹集团，实际控制人仍为上海市国资委，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响

根据上市公司财务报告及安永会计师审阅的上市公司备考财务报表，不考虑募集配套资金，本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：

单位：万元

项目	2025年度/2025年12月31日		2024年度/2024年12月31日	
	上市公司	备考报表	上市公司	备考报表
资产总额	10,012,329.13	10,610,932.80	8,793,523.15	9,356,042.83
负债总额	3,702,853.87	4,092,273.00	2,521,468.25	2,965,008.50
归属于母公司股东权益	4,516,029.04	4,725,213.57	4,360,233.22	4,474,671.92
营业收入	1,729,145.07	2,228,795.71	1,438,830.77	1,927,405.55
利润总额	-65,100.61	11,125.88	-98,831.81	-36,817.13
净利润	-80,714.30	-4,487.81	-103,218.38	-41,203.70
归属于母公司股东净利润	37,661.14	118,428.37	38,057.62	95,531.55
基本每股收益（元/股）	0.22	0.62	0.22	0.50

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司合并范围内的子公司，根据模拟测算本次交易完成后上市公司资产规模、收入规模、盈利能力均有较大提升。

五、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

截至重组报告书签署日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易已经上市公司2025年第六次董事会会议、2025年第九次董事会会议、2026年第三次董事会会议审议通过；

2、本次交易已取得上市公司持股5%以上股东的原则性意见；

3、本次交易已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；

4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；

5、本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案；

6、上市公司股东大会审议通过本次交易；

7、香港证监会及联交所必要的审批程序。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至重组报告书签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、审查、备案或许可（如适用）。

本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见

上市公司直接控股股东华虹国际、间接控股股东华虹集团已出具《关于上市公司本次交易的原则性意见》，原则性同意本次交易。

七、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东已出具《关于股份减持计划的承诺函》

上市公司直接控股股东华虹国际已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业无减持上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持上市公司股份。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

上市公司间接控股股东华虹集团已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本企业无主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份的计划。自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，本企业不主动减持本企业直接及间接持有的上市公司股份，前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本企业承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

3、本企业知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本企业承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

（二）上市公司董事、高级管理人员已出具《关于股份减持计划的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、自本承诺函出具之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定，且上述承诺不能满足相关规定的要求时，本人承诺届时将按照新的规定出具补充承诺或重新出具新的承诺。

4、本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，由此给华虹半导体或者其他投资者造成损失的，本人承诺将向华虹半导体或其他投资者依法承担赔偿责任。”

八、本次交易对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规的要求履行了现阶段必要的信息披露义务。上市公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求，及时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

（二）确保本次交易的定价公平、公允

上市公司已聘请符合《证券法》规定的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，以确保本次交易的定价公允、公平、合理，定价过程合法合规，不损害上市公司股东利益。

（三）严格执行相关决策程序

本次交易涉及的董事会、股东会等决策程序，公司遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中规定的程序进行决策审批。

（四）网络投票安排和中小股东单独计票

根据有关规定，上交所通过交易系统和互联网投票系统向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票，以切实保护股东的合法权益。

针对审议本次交易的股东大会投票情况，上市公司对A股股东单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。

（五）关联董事、关联股东回避表决

根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会审议本次交易时，已提请关联董事回避表决相关议案；上市公司在召开股东大会审议本次交易时，已提请关联股东回避表决相关议案，从而充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）股份锁定安排

本次重组交易对方就认购股份的锁定期出具了承诺，具体内容详见本报告书摘要“第一节 本次交易概况”之“八、本次交易相关方所作出的重要承诺”。

本次发行结束之日后，交易对方基于本次发行而享有的上市公司送股、配股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排与证券监管机构的最新监管规定不相符，将根据相关监管规定进行相应调整。锁定期届满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。

（七）本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施

根据上市公司财务报告及安永会计师审阅的上市公司备考财务报表，本次交易完成前后，上市公司每股收益的变化情况如下：

项目	2025年度		2024年度	
	交易前	备考数	交易前	备考数
基本每股收益（元/股）	0.22	0.62	0.22	0.50

如上市公司或标的公司未来盈利能力不及预期，本次交易存在导致上市公司即期回报被摊薄的可能。为了充分保护公司公众股东的利益，公司制定了防止本次交易摊薄即期回报的相关填补措施。公司制定填补回报措施不等